

比亚迪半导体暂别“车芯第一股”

■ 本报实习记者 杨梓

11月15日,比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)宣布,终止旗下比亚迪半导体股份有限公司(以下简称“比亚迪半导体”)分拆至深圳证券交易所创业板上市。目前离IPO只差临门一脚的比亚迪半导体为何要暂别“车芯第一股”?

晶圆产能遇瓶颈

在比亚迪半导体尝试分拆上市期间,我国新能源汽车行业需求呈爆发式增长。中汽协的数据显示,今年前10个月,我国新能源汽车销量达到548.5万辆,同比增长1.1倍。根据此前的预测,今年全年,新能源汽车销量将达600万辆。

比亚迪表示,新能源汽车行业的高速增长态势,使得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能的瓶颈。比亚迪半导体为了扩大晶圆产能,在审期间已投资实施济南功率半导体产能建设项目。济南项目目前已成功投产,产能爬坡情况良好,但面对新能源汽车行业的持续增长,新增晶圆产能仍远不能满足下游需求。

为尽快提升产能供给能力和自主可控能力,比亚迪半导体拟抢抓时间窗口,开展大规模晶圆产能投资建设。在济南项目基础上,进一步增加大额投资,预计对比亚迪半导体未来资产和业务结构将产生较大影响。为加快晶圆产能建设,综合考虑行业发展情况及未来业务战略定位,统筹安排业务发展和资本运作规划,决定终止推进本次分拆上市。

有业内人士分析称,比亚迪的言外之意就是比亚迪半导体认为提升晶圆产能才是目前工作的重中之重。

据了解,晶圆作为芯片的原材料,其产能会直接影响芯片产量。近年来,全球车企饱受“缺芯”困扰。汽车行业数据预测公司AFS的最新数据显示,截至11月20日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产约405.51万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产产量将达到442.28万辆。同时,受下游新能源汽车产业快速发展带动,车辆所需芯片数量成倍增加。基于此,包括比亚迪半导体在内的半导体厂商均在持续扩产。

上市之路一波三折

招股书显示,比亚迪半导体前身为比亚迪微电子,成立于2004年10月,于2020年更名为比亚迪半导体,主营业务包括功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。在汽车领域,比亚迪半导体已进入小鹏汽车、东风岚图、宇通汽车、小康汽车、长安汽车等品牌客户的供应商体系。在国内新能源汽车电机驱动控制器用IGBT模块中,比亚迪半导体在2019年、2020年的市场占有率达到19%,仅次于英飞凌。2020年通过两轮超过27亿元的融资引入



了包括中金、红杉、先进制造基金、小米产业基金等众多知名机构,目前比亚迪控股72.3%。

一直以来,关于比亚迪半导体上市的消息不断,直到2020年12月30日,比亚迪发布公告称,董事会同意比亚迪半导体分拆上市,并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆比亚迪半导体上市的前期筹备工作。2021年6月,比亚迪半导体创业板IPO申请获深交所受理;今年1月27日,获创业板上市委审核通过。

不过,比亚迪此前的上市之路并非一帆风顺。事实上,比亚迪半导体曾于2021年8月、9月以及今年3月、9月因上市律所遭调查、申请文件中记载的财务资料过期导致上市进程四次被打断,并最终于今年11月15日按下终止键。

将择机再启动上市

数据显示,2019-2021年,比亚迪半导体营收分别为10.96亿元、14.41亿元、31.66亿元,净利润分别为8511.49万元、5863.24万元、3.95亿元。

值得注意的是,虽然比亚迪半导体第三方销售拓展呈上升趋势,但短期内第三方销售总体规模仍较小,比亚迪半导体的营收大部分依赖于比亚迪。招股书显示,2019-2021年,比亚迪半导体向关联方比亚迪销售商品、提供劳务及合同能源管理服务的金额分别为6.01亿元、8.48亿元、20.06亿元,占总收入的比例由54.81%升至63.37%。关联交易占比较高也使得深交所

曾对比亚迪半导体的业务独立性、财务独立性和资产独立性分别进行了问询。

同时,关于比亚迪半导体的晶圆产能,证监会在此前也曾提出问询。证监会认为,目前多数国际主流半导体设备厂商将资源更多投在12英寸设备研发及生产上,要求比亚迪半导体说明大规模投资8英寸晶圆生产设备的商业合理性。

今年7月,比亚迪半导体回复称,8英寸晶圆设备适配车规级功率半导体应用,行业产能供给增速无法匹配下游领域快速增长的市场需求。购买的8英寸功率半导体晶圆制造设备主要是以现阶段晶圆制造工艺及技术积累为基础,快速形成有效产能,有效解决短期内新能源汽车行业面临的功率半导体需求缺口,12英寸晶圆制造产线由于制造工艺及可靠性验证等因素,可能要花费3-5年时间才能形成完全匹配下游需求的产能,无法及时满足新能源汽车快速增长的市场需求。

比亚迪表示,比亚迪半导体将继续投资建设晶圆产能,进一步深化垂直整合,最大程度缓解产能瓶颈,增强车规级功率半导体的产能供给能力和自主可控能力,有效满足下游新能源汽车行业不断扩张的整体市场需求,进而巩固比亚迪半导体的可持续竞争优势,维持其行业领先地位,提升持续盈利能力。

同时,比亚迪表示,待完成相关投资扩产后,公司将择机再次启动比亚迪半导体的分拆上市工作。

ABB 移动式快充设备 助力电动方程式赛车新赛季

本报讯 ABB 近日公布了在 ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛第九赛季中将使用的充电技术。届时,ABB 将成为该系列赛事的官方充电供应商。

据悉,此次 ABB 提供的移动式快速充电设备,将在赛前和比赛过程中为全新的第三代电动方程式赛车充电。每个充电设备的功率可达 160kW,能够在比赛前以各 80kW 的功率同时为两辆赛车充电,大大减少了充电设备的占地面积,还减少了运输设备导致的排放。据了解,ABB 的移动式快速充电设备已经在公路车充电应用中得到了验证,可以适配全球的电源系统。

ABB 电动交通首席执行官弗兰克·米隆(Frank Mühlhölzer)表示:“我们很高兴将创新的充电解决方案带到世界瞩目的电动汽车舞台——ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛。为第三代赛车提供充电支持能够让我们获取在快节奏、高竞争度的环境中进行充电的宝贵信息。我们会将这些经验和知识用于对 ABB 充电设备的不断改进中。”

电动方程式锦标赛首席执行官杰米·莱格(Jamie Reigle)表示:“技术进步和可持续创新是 ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛的基石。我们与 ABB 的合作是基于对推进电动出行的共同承诺。ABB 的移动式快速充电设备确立了行业标准,并将成为电动方程式赛车赛事的关键充电基础设施。我们期待在严格的赛事标准下展示 ABB 领先的充电产品,并由此证明高性能和可持续性两者不矛盾,可以共存。”

据了解,ABB 于 2010 年进入电动汽车市场,目前已在全球超过 85 个市场中售出了超过 4 万个直流快速充电桩和 80 万个交流充电桩。(穆紫)

博世智能驾驶研发中心启用

本报讯 11月22日,博世宣布,旗下未来智能驾驶与控制(上海)研发中心正式落成启用。

据悉,新研发中心是博世智能驾驶与控制事业部继苏州工业园区、上海虹桥临空经济园区之后在中国设立的第三个研发中心,同时也是规模最大的研发中心。该研发中心位于上海浦东金桥,总投资额超过1.5亿元人民币,办公面积超过1万平方米,未来将有超过540名研发人员在此从事智能座舱与高阶智能驾驶领域的技术研发,尤其是软件相关的研发工作。

新研发中心的落成启用,将进一步提升博世在未来出行领域的本土研发实力,更好服务本土市场,助力客户应对软件定义汽车的产业变革。

“汽车产业正向电气化、自动化、互联化以及个性化加速变革,尤其是在中国市场。”博世集团董事会主席史蒂芬·哈通博士表示:“我们非常高兴博世能够积极参与和支持中国市场汽车智能化与电动化发展。相信伴随新研发中心的建立,博世将为中国以及全球客户提供更多智能汽车解决方案。”(穆紫)



少一个纸杯 多一片绿色